



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 8

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	8
行数	1

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色



接触件特性

接合插针直径	.63 mm[.024 in]
接合方柱尺寸	.63 mm[.024 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 – 5 µm[118.11 – 196.85 µin]
端子布局	直插式
端子保护类型	闭合入口壳体
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度的	3.1 mm[.122 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	固定焊尾
PCB 安装固定	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	7 mm[.276 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F][-67 – 221 °F]
--------	--

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
--------	-----

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	88
封装方法	Carton

产品合规性

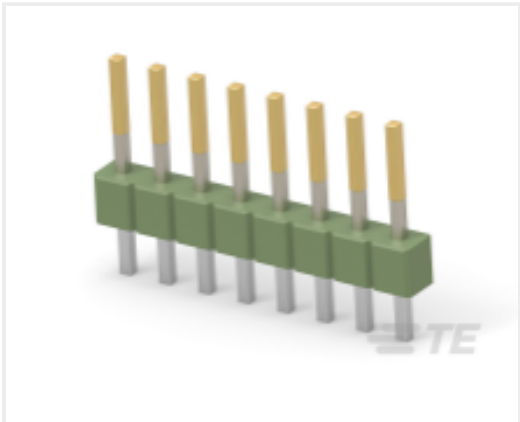
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



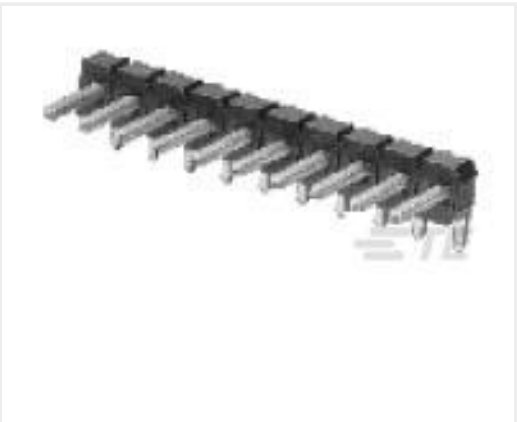
TE 产品编号 826629-8
AMPMODU II HEADER



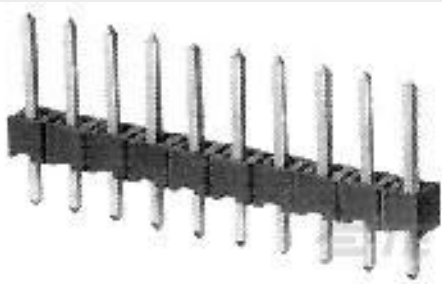
TE 产品编号 826630-8
8P AMPMODU II STIFT LEI



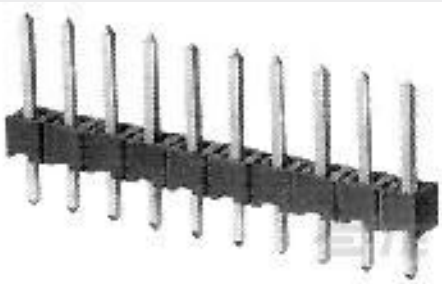
TE 产品编号 1241150-8
8P MOD II BREAK AWAY HDR , SMD, BLISTER



TE 产品编号 826631-8
AMPMODU II PIN HEADER



TE 产品编号 826648-8
08P AMPMODU II PIN HDR.



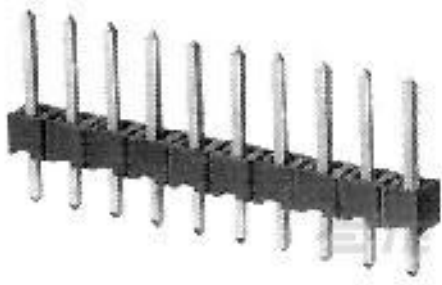
TE 产品编号 826646-8
8P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 966710-8
MODU II PIN HEADER, SGL ROW,
SMD- 8 POS

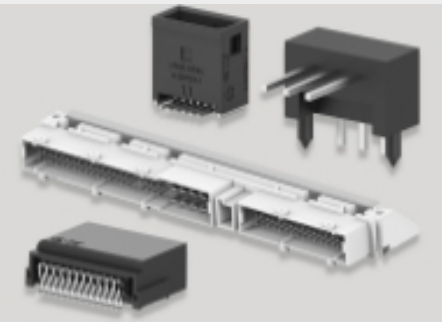


TE 产品编号 966306-8
MOD2 ST-LEI SMD 8P

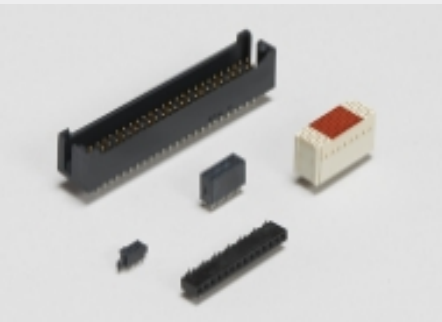


TE 产品编号 826647-8
8P AMPMODU II STIFT LEI

该系列中的其他产品 | AMPMODU HV-100/HV-190

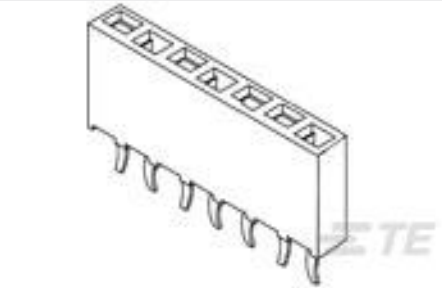


PCB 板端连接器及母端(321)



板对板接头和插座(321)

客户还购买了



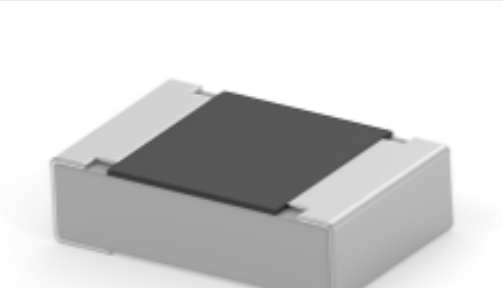
TE 产品编号215297-9
9P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号4-440052-3
2.5MM,HDR,3POS,VERTICAL,
CONNECTOR



TE 产品编号3-1393236-7
V23092-A1048-A301



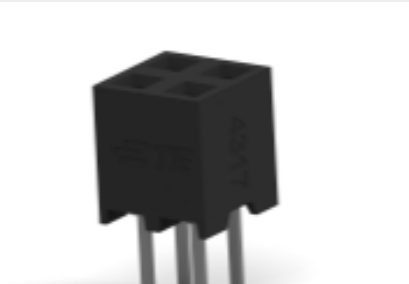
TE 产品编号1-2176342-0
CRGCQ 0805 33R 5%



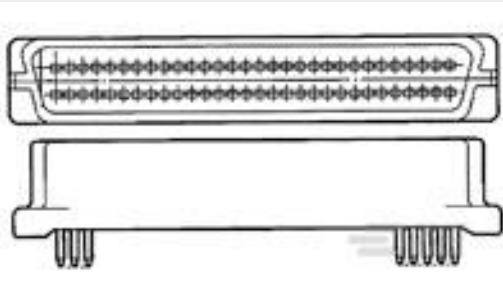
TE 产品编号3-2176347-7
CRGCQ 2010 10K 1%



TE 产品编号3-2176403-9
3550 39R 1%



TE 产品编号2314812-4
4P,2MM,BB,REC,DRVT,2.0,0.1AUTUBE
W/CAP



TE 产品编号6-5174216-4
AMPLIMITE.050 CAP ASS'Y (V) 60P PB-
FREE



文档

产品图纸

8P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_215297-8_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_215297-8_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_215297-8_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1773393_ AMPMODU_EUROPEAN_STANDARD_PRODUCTS

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本